

Compact radio frequency Sputtering System

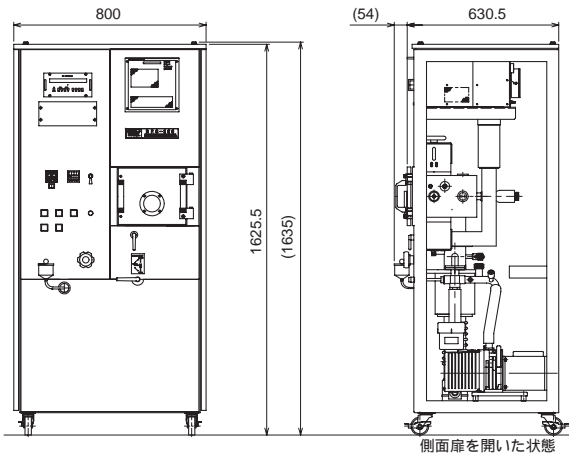
小型スパッタリング装置

高周波スパッタリング装置

RFS-200



Optional Parts  
・電離真空計



仕様 Specifications

ターゲット Standard target	80 1~5t
真空槽 Vacuum chamber	200mm(W)×250mm(D)×150mm(H) SUS-304 前面扉式
基板 Substrate electrode	80mm Cu製 加熱・冷却式
カソード Cathode	80mm Cu製 冷却
シャッター Shutter	95mm×1t 手動操作
RF電源 RF power supply	200W 13.56MHz
基板加熱電源 Power supply for substrate heating	デジタル自動温度調節 Max 350
排気系 Vacuum system	油拡散ポンプ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "、240 <sup>1</sup> / <sub>sec</sub> . 油回転ポンプ G-100D 100 <sup>1</sup> / <sub>min</sub> .
外形寸法・質量 Dimensions・Weight	800mm(W)×630mm(D)×1625.5mm(H) 200kg
所要電力 Power requirement	1 100V 1.3kVA
RF電源 Power requirement for RF	1 100V 0.5kVA
冷却水量 Cooling water requirement	200kPa, 5 L/min 20 以下
到達圧力 Ultimate pressure	6.7×10 <sup>-4</sup> Pa
排気時間 Evacuation time	10 <sup>-3</sup> Pa台5min.
スパッタ圧力 Sputtering pressure	10 <sup>-1</sup> Pa Ar

オプションパーツ Optional parts

液体窒素トラップ	インライントラップ (OMI-100)
マグネトロン	ターゲット
基板加熱650	Al・Cu・Au・Cr・Si・Ge・Se
導入ガス2系統、3系統	SiO <sub>2</sub> ・Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 他
電離真空計	

写真のOptional partsは標準装備していません。

Compact Ion-Sputtering System

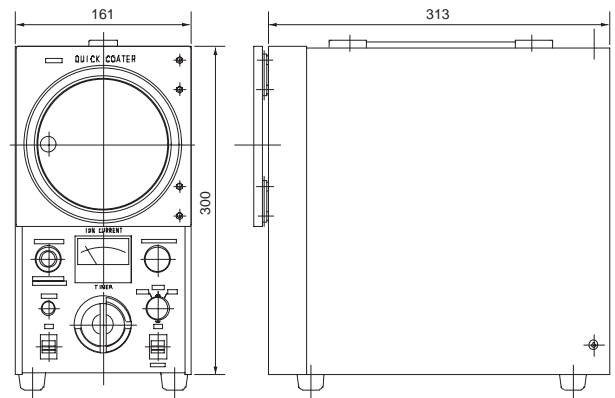
小型スパッタリング装置

イオンスパッタリング装置

VPS-020/050



VPS-020



図はVPS-020

仕様 Specifications

	VPS-020	VPS-050
標準ターゲット Standard target	50mmAu1個 (コーティング用) 50mmAl1個 (エッチング用)	100mmAu (コーティング用) 100mmAl1個 (エッチング用)
試料台 Specimen base	70mm (高さ調節範囲 Height adjust 15mm, 20mm, 60mm)	100mm
チャンバー Chamber	120mm, 120mm (D)	240mm, 240mm (D)
ロータリーポンプ Rotary pump	15吸気管付 G-20DA型 (20 L/min)	オプション G-100D型 (100 L/min)
高圧電源 High voltage power supply	1 kV / 0 ~ 20mA (電流計付、安全回路組込)	
コーティング方法 Coating method	AC / DC Sputtering	
エッチング方法 Etching method	AC / DC Sputtering	
タイマー Timer	0 ~ 15min連続可変	
ガス調整機構 Gas regulating mechanism	ニードルバルブ	
所要電力 Power requirement	1 100V 0.4kVA	1 100V 0.5kVA
外形寸法・質量 Dimensions・Weight	160mm(W)×365mm(D)×317mm(H) 8.5kg	282mm(W)×485mm(D)×440mm(H) 20kg

注)「VPS-050」のロータリーポンプは標準装備していません。  
別途ご注文ください。

オプションパーツ Optional parts

ターゲット	Pt-Pd, Ag 他
-------	-------------